

供給確保計画の概要

1. 認定の日付

令和6年11月29日

2. 供給確保計画の認定番号

2024半導体第1号-1

3. 供給確保事業者の名称等

富士電機株式会社

株式会社デンソー

4. 認定供給確保計画の概要

- 安定供給確保を図ろうとする特定重要物資又はその生産に必要な原材料等の品目
従来型半導体 (SiC パワー半導体)、半導体部素材 (SiC エピタキシャルウエハ、SiC ウエハ)
- 特定重要物資等の安定供給確保に関する目標
SiC パワー半導体、SiC エピタキシャルウエハ及び SiC ウエハの国内における生産能力の強化
- 取組において支援措置の対象とする取組の内容
 - 取組の種類：1. 生産基盤の整備
 - ・施設の所在地：松本市（長野県）、幸田町（愛知県）、いなべ市（三重県）
 - ・主要製品：SiC パワー半導体、SiC エピタキシャルウエハ及び SiC ウエハ

	生産場所	供給開始	生産能力
SiC パワー半導体	松本市	2027年5月	31万枚/年（8インチ換算）
SiC エピタキシャルウエハ	松本市	2027年5月	24万枚/年（8インチ換算）
SiC エピタキシャルウエハ	幸田町	2026年9月	10万枚/年（8インチ換算）
SiC ウエハ	いなべ市	2026年9月	6万枚/年（8インチ換算）

(※) 供給開始の日から10年以上の継続生産を予定

- 取組を実施するために必要な資金の額：2,116億円（最大助成額：705億円）
- 希望する支援措置
助成金交付